

様

PCN-SM2117
2021 年 12 月 17 日
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社
品質保証部
部長 長沼裕之



Tube 出荷品(SOP8 150mil 以外)の包装仕様の追加について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、現在貴社にご採用いただいております製品につきまして、
納入時に使用する包装材の仕様を追加させていただきます。
変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

敬 具

- 記 -

1. 対象製品

- ・ SOP8 (208mil) パッケージで、Tube 包装形態で納入している製品
MB85RC256VPF-G-JNE2、 MB85RS2MTPF-G-JNE2、 MB85RS4MTPF-G-JNE2
- ・ SOP28 パッケージで、Tube 包装形態で納入している製品
MB85R256FPNF-G-JNE2
- ・ TSSOP16 パッケージで、Tube 包装形態で納入している製品
MB97R8130PFT-G-JNE1

2. 追加内容

- ・ 防湿アルミラミネート袋の仕様追加
- ・ 湿度インジケータの仕様追加
- ・ 内装箱の仕様追加

3. 追加理由

対象製品の現行包装仕様は弊社専用仕様の為、現在の半導体市況で、安定した調達が難しくなっています。 その為、安定した製品納入を継続できるよう、委託先で汎用として使用している包装仕様も追加し、「現行仕様と追加仕様」の併用にて納入とさせていただきたく、ご理解とご協力をお願い致します。

4. 追加予定時期

2022 年 3 月中旬以降の納入より適用させていただきます。

5. 追加する包装仕様

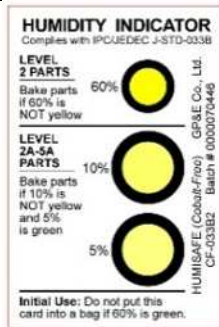
追加仕様については、次頁にあります現行仕様と追加仕様内容を参照願います。
なお、仕様追加による製品の品質、保証に変更はございません。

現行仕様と追加仕様内容

□防湿アルミラミネート袋 現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
外形サイズ	幅:120, 長さ:750, 厚:0.09 mm	幅:222, 長さ:722, 厚:0.15mm
外観		

□湿度インジケータ 現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
検知湿度	30%	5% 10% 60% (JEDEC 準拠)
外観		

□内装箱 現行仕様と追加仕様

仕様	現行仕様	追加仕様
外形サイズ	印字だけが異なります。 外形サイズに差異はありません。	
外観	上面  側面 	上面  側面 
	① FUJITSU ロゴあり ② FUJITSU マークあり ③ 取り扱い注意	① FUJITSU ロゴなし ② FUJITSU マークなし ③ DELICATE PARTS HANDLE WITH CARE

以上